# **Pressemitteilung**

Nr.: REN0691(A)

# **Renesas erweitert mit drei neuen MCU-Gruppen seine Mikrocontroller-Palette für die Renesas Synergy™ Plattform**

# Die S128, S3A3 und S3A6 Group decken das komplette Portfolio von skalierbaren und kompatiblen Synergy MCUs innerhalb der Synergy Plattform ab

**Düsseldorf, 30. März 2017** – Renesas Electronics hat sein Mikrocontroller-(MCU)-Portfolio innerhalb der Renesas Synergy™ Plattform erweitert. Das Unternehmen bietet damit eine noch breitere Palette an Funktionen, CPU-Leistung und Speicherumfang. Systementwickler erhalten damit genau die MCUs, die sie benötigen, um damit innovative Lösungen für ihre Branche entwickeln zu können. Dieses erweiterte Spektrum skalierbarer und kompatibler MCUs bietet viele Optionen zur Entwicklung von Endprodukten, bei denen einmal investierte Entwicklungsressourcen für Hard- und Software in hohem Maße wiederverwendbar sind. Mit den neuen Synergy MCU-Gruppen S128, S3A3 und S3A6 gibt es jetzt insgesamt sieben MCU-Gruppen mit 57 Bausteinen auf Basis des ARM® Cortex®-M CPU Cores mit Taktfrequenzen von 32 MHz bis 240 MHz und sowie On-Chip Flashspeicher von 64 kB, 128 kB, 256 kB, 384 kB, 512 kB, 768 kB, 1 MB, 2 MB, 3 MB und 4 MB. Renesas wird kontinuierlich seine Synergy MCU-Gruppen weiterentwickeln und ausbauen.

Die 20 neuen Synergy MCU-Bausteine in den Produktgruppen S128, S3A3 und S3A6 sind ab sofort als Muster für ausgewählte Kunden erhältlich und im Juni 2017 allgemein verfügbar.

Seit der Markteinführung im Oktober 2015 ist der Funktionsumfang der Synergy-Plattform beträchtlich gewachsen. Im Software-Bereich zeigt sich dies in der Erweiterung des Synergy Software Package (SSP) mit einem beispiellos hohen Maß an Software-Qualitätssicherung. Bei den Partnerlösungen sind zahlreiche neue Verified Software Add-Ons (VSAs) hinzugekommen. Im Bereich der Software-Entwicklungswerkzeuge zeigt sich dies durch die Einbindung der IAR Embedded Workbench® für Renesas Synergy™. Bei der Hardware kamen schließlich neue Synergy Kits und zusätzliche MCU-Bausteine dazu, auf die über das API (Application Programming Interface) der SSP ein vollständiger Zugriff möglich ist. Der kontinuierliche Ausbau der Synergy Plattform inspiriert Systementwickler zu Innovationen im Bereich Embedded-Steuerungen sowie IoT-Anwendungen, wobei es kaum Hindernisse beim Einstieg in ein neues Design gibt. Dank dieses Plattform-Konzepts profitieren Unternehmen erheblich von kürzeren Markteinführungszeiten sowie geringeren Gesamtbetriebskosten über den gesamten Lebenszyklus ihrer Produkte.

„In den letzten 18 Monaten hat Renesas die Synergy-Plattform umfassend weiterentwickelt. In jeder Phase der Entwicklung unterstützt sie unsere Kunden dabei, einen echten Mehrwert ihren Endprodukten hinzuzufügen“, erklärt Peter Carbone, Vice President of Synergy IoT Platform Business Division, Renesas Electronics Corporation. „Mit der Erweiterung unseres MCU-Portfolios für die Synergy Plattform durch diese drei neuen MCU-Gruppen deckt unser Angebot jetzt das gesamte, von unseren Kunden geforderte Auswahlspektrum an Speicher- und Gehäusegrößen ab. Damit bieten wir die Möglichkeit zwischen den einzelnen Produkten einfach auf- und abwärtsskalieren zu können, einschließlich Software und Tools für geringeren Arbeitsaufwand bei Redesigns. Dies sind die Grundprinzipien der Synergy Plattform, mit denen sich die Markteinführungszeiten verringern und die Gesamtbetriebskosten für unsere Kunden senken lassen.“

**MCU-Bausteine der S128, S3A3 und S3A6 Group**

Systementwickler mit schlankeren Anforderungen können Bausteine aus den Produktgruppen S3A3 und S3A6 nutzen, um ihre Anwendungen anders als bei den bestehenden 1 MB Flash MCUs der S3A7-Gruppe bei Bedarf zu Flashspeicher-Größen von 512 kB und 256 kB herunterzuskalieren. Die S128-Gruppe bietet zusätzliche Auswahlmöglichkeiten für Ultra-Low-Power-Anwendungen, die größeren Speicher bis 256kB benötigen oder im Vergleich zu den MCUs der bestehenden S124-Gruppe eine zusätzliche analoge Signalkonditionierung erfordern.

Renesas wird am 11. April auf der Renesas DevCon Japan 2017 in Tokio eine Reihe von Produktdemos der jüngsten Innovationen rund um die Synergy Plattform zeigen, wie das neueste Synergy Software Package (SSP) Version 1.2.0, das WiFi-Framework sowie eine abgesicherte Referenzlösung für die Fertigung mit den vor kurzem vorgestellten Secure MCUs der Synergy S5D9 Group.

Mehr Informationen über die Renesas Synergy Plattform unter: [www.renesassynergy.com](http://www.renesassynergy.com).

**Über Renesas Electronics Europe**

Renesas liefert mit seinen umfassenden Halbleiterlösungen innovatives Embedded-Design. Als weltweite Nummer eins im Markt für Mikrocontroller und einer der führenden Anbieter von A&P- und SoC-Produkten steht Renesas für langjährige Expertise und höchste Qualität. Mit seiner breiten Lösungspalette fokussiert Renesas auf die Anwendungsbereiche Automotive, Industrie, Smart Home, Büroautomation sowie Informations- und Kommunikationstechnologie. Das im Jahr 2010 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Japan. Mit mehr als 800 Hardware- und Software-Alliance-Partnern weltweit verfügt das Unternehmen über das größte lokale Support-Netzwerk der Branche. Die europäische Firmenstruktur besteht aus den zwei Geschäftsbereichen Automotive und Industrial sowie dem Global ADAS Centre und der Engineering Group.

Weitere Informationen unter: [www.renesas.](http://www.renesas.)com

Renesas Electronics Europe informiert auch auf <http://twitter.com/Renesas_Europe>, <http://facebook.com/RenesasEurope> und <http://youtube.com/RenesasPresents>.

**Hinweis**

ARM und Cortex sind eingetragene Warenzeichen von ARM Limited (oder ihrer Tochterunternehmen) in der EU und/oder anderen Ländern. IAR Embedded Workbench ist ein eingetragenes Warenzeichen von IAR Systems. X-Ware ist ein Warenzeichen von Express Logic, Inc. Renesas Synergy ist ein Warenzeichen der Renesas Electronics Corporation. Alle anderen eingetragenen Warenzeichen oder Warenzeichen sind Eigentum ihrer entsprechenden Inhaber.

**Unternehmenskontakt für Leser- und Kundenanfragen:**

Oliver Lüttgen

Renesas Electronics Europe GmbH, Arcadiastr. 10, 40472 Düsseldorf
Tel.: +49 211 65 03-1469
E-Mail: Oliver.Luettgen(at)renesas.com
Web: [www.renesas.com](http://www.renesas.com)

**Agenturkontakt für weitere Presseinformationen, Bildmaterial oder Artikelanfragen:**

Alexandra Janetzko

HBI Helga Bailey GmbH (PR-Agentur), Stefan-George-Ring 2, 81929 München

Tel.: +49 89 99 38 87-32

Fax: +49 89 930 24 45

E-Mail: alexandra\_janetzko@hbi.de

Web: [www.hbi.de](http://www.hbi.de/)